PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-261977

(43) Date of publication of application: 26.09.2001

(51)Int.CI.

C08L101/00 C08J 5/00 C08K HO5K H010 HO1Q HO1S

(21)Application number : 2000-074755

(71)Applicant : MIYAMOTO YOSHIO

JSR CORP

(22) Date of filing:

16.03.2000

MIYAMOTO YOSHIO (72)Inventor:

> KAJIYAMA KENJI KIRIHARA SATOHIDE

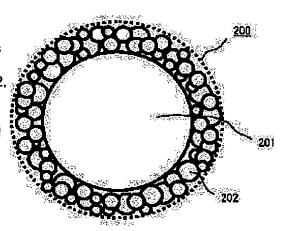
TAGAMI EIJIRO

(54) THREE-DIMENSIONAL PERIODIC STRUCTURE AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a threedimensional periodic structure having a high permittivity and readily producible at a low cost and to provide a method for producing the structure.

SOLUTION: This three-dimensional periodic structure is formed by covering the outer peripheral surface of each particle 201 comprising first ceramics composed of TiO2, SrTiO3, BaTiO3, etc., with plural particles 202 comprising second ceramics composed of SiO2, etc., thereby composing ceramic secondary particles 200 and laminating two-dimensional basic structures with a mixture prepared by uniformly dispersing the ceramic secondary particles 200 in a photo-setting resin composition while successively forming the twodimensional basic structures according to a stereolithographic method.



LEGAL STATUS

THE WAY WANT WANT

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPT))

4.54

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

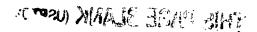
[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



THIS PAGE BLANK (USPT))

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-261977A) (P2001-261977A) (43)公開日 平成13年9月26日(2001.9.26)

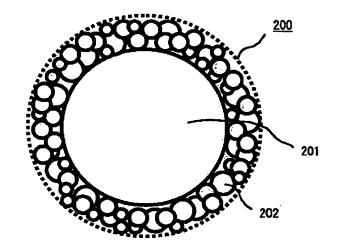
(51) Int. C1. 7	識別記号		FI	テーマ	コード(参考)		
C 0 8 L	101/00		CO8L 101/00	2Н0	47		
C08J	5/00		CO8J 5/00	4F0	71		
C08K	3/22		C 0 8 K 3/22	4J0	4J002		
	3/24		3/24	5E3	21		
C 0 8 L	101/12		C 0 8 L 101/12	5F0	73		
	審査請求 未請求 請求項の数11	OL		(全11頁)	最終頁に続く		
(21)出願番号	特願2000-74755 (P2000-74755)		(71)出願人 592138 宮本				
(22)出願日 平成12年3月16日(2000.3.16)			大阪府池田市槻木町1番14-202号				
			(71)出願人 000004				
				エスアール株式会社			
			東京都	中央区築地2丁目11	番24号		
			(72)発明者 宮本	欽生			
		1	大阪府	池田市槻木町1番14	202号		
			(72)発明者 梶山	健二			
			神奈川	県川崎市麻生区王神	単寺2418-66		
			(74)代理人 100098	305			
			弁理士	福島 祥人			
					最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】三次元周期構造体およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 高い誘電率を有し、容易かつ安価に製造可能な三次元周期構造体およびその製造方法を提供することである。

【解決手段】 第1のセラミックスからなる粒子201の外周面を第2のセラミックスからなる複数の粒子202で被覆することにより、セラミックス二次粒子200が構成される。第1のセラミックスはTiO2、SrTiO3、BaTiO3等からなり、第2のセラミックスはSiO2等からなる。セラミックス二次粒子200を光硬化性樹脂組成物中に均一に分散させた混合物により二次元基本構造体を光造形法により順次形成しつつ積層し、三次元周期構造体を形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 樹脂組成物および誘電体粒子の混合物を 硬化させることにより形成される複数の単位構成要素が 三次元周期的に組み合わされ、前記誘電体粒子が複数種 類の誘電体材料の複合体からなることを特徴とする三次 元周期構造体。

【請求項2】 前記複数種類の誘電体材料は第1の誘電 体材料および第2の誘電体材料を含み、前記第1の誘電 体材料は前記第2の誘電体材料よりも高い誘電率を有 し、前記第2の誘電体材料は前記第1の誘電体材料に比 10 べて前記樹脂組成物の硬化を妨げないことを特徴とする 請求項1記載の三次元周期構造体。

【請求項3】 前記誘電体粒子は、前記第1の誘電体材 料からなる粒子の表面が前記第2の誘電体材料からなる 複数の粒子で取り囲まれてなる二次粒子であることを特 徴とする請求項1または2記載の三次元周期構造体。

【請求項4】 前記誘電体粒子は、前記第1の誘電体材 料からなる粒子と第2の誘電体材料からなる粒子とが混 合されて一体化されてなる二次粒子であることを特徴と する請求項1または2記載の三次元周期構造体。

【請求項5】 前記誘電体粒子は、前記第2の誘電体材 料の溶融凝固体中に前記第1の誘電体材料からなる粒子 が混入されてなる二次粒子であることを特徴とする請求 項1または2記載の三次元周期構造体。

【請求項6】 前記第1の誘電体材料は第1のセラミッ クスであり、前記第2の誘電体材料は第2のセラミック スであることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記 載の三次元周期構造体。

前記第1の誘電体材料はセラミックスで 【請求項7】 あり、前記第2の誘電体材料はガラスまたはポリマであ 30 ることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の三 次元周期構造体。

【請求項8】 前記第2の誘電体材料は酸化シリコンで あることを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の 三次元周期構造体。

【請求項9】 前記第1の誘電体材料は酸化チタン、チ タン酸ストロンチウム、チタン酸バリウム、酸化タンタ ル、酸化鉛および酸化バリウムよりなる群から選択され た1または複数のセラミックスであることを特徴とする 請求項1~8のいずれかに記載の三次元周期構造体。

【請求項10】 前記樹脂組成物は光硬化性樹脂組成物 であることを特徴とする請求項1~9のいずれかに記載 の三次元周期構造体。

【請求項11】 複数種類の誘電体材料の複合体からな る誘電体粒子を形成し、光造形法により、樹脂組成物お よび前記誘電体粒子の混合物を硬化させることにより複 数の単位構成要素を周期的に配列してなる二次元基本構 造体を形成し、複数の前記二次元基本構造体を積み重ね ることにより三次元周期構造体を製造することを特徴と する三次元周期構造体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、フォトニック結晶 を構成する三次元周期構造体およびその製造方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】屈折率が周期的に変化する三次元周期構 造体は、電磁波に対する干渉作用を示し、特定の周波数 領域の電磁波の通過を禁止する。すなわち、特定の波長 の光を遮蔽することができる。この場合の禁止帯はフォ トニックバンドギャップと呼ばれ、三次元周期構造体は フォトニック結晶と呼ばれる。また、特定の波長の電磁 波を遮蔽する効果はフォトニックバンドギャップ効果と 呼ばれる。このような三次元周期構造体は、高効率半導 体レーザ素子や光導波路等の光デバイスへの応用が期待 されている。

【0003】例えばE. Yablonovitch, "Photonic bandgap structures", J. Opt. Soc. AmB, vol. 10, no. 2, pp. 283-295, 1993に三次元周期構造体の構成例が提案され 20 ている。また、特開平10-335758号公報には、 スパッタエッチングを用いて1μm程度またはそれ以下 の周期を有する三次元周期構造体を作製する方法が開示 されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、所望の 屈折率および所望の三次元的周期を有する構造を容易に 作製できる技術が確立されていないため、三次元周期構 造体を応用したデバイスは実用化されていない。特に、 ミリ波領域からマイクロ波領域の電磁波を制御可能な三 次元周期構造体の構造および作製方法については開発さ れていない。

【0005】高速大容量の通信に適した通信インフラス トラクチャを構築するためには、ミリ波帯またはマイク 口波帯の通信の高性能化を図る必要がある。しかし、電 磁波の発振出力が数ワットになると、電磁障害が発生す る可能性があるので、通信の高性能化および電磁障害防 止の両立性を確保する必要があり、電磁障害防止機能を 備えた高性能通信機器が求められる。

【0006】また、人工衛星や飛行船を中継基地とする 40 高速大容量通信システム、グローバル移動体通信システ ム、および高度道路交通システムでは、ミリ波帯または マイクロ波帯の通信を行う安価な高性能小型通信機器が 大量に必要とされ、しかも電磁障害を防止する必要も生 じる。

【0007】したがって、光領域のみならず、ミリ波領 域からマイクロ波領域の電磁波を制御するデバイスが望 まれる。

【0008】本発明者は、光造形法を用いて樹脂および セラミックス粒子の混合物により形成される複数の単位 50 構成要素を三次元周期的に組み合わせることにより三次

元周期構造体を作製する方法を提案している。

【0009】この作製方法により作製された三次元周期 構造体においては、単位構成要素が樹脂およびセラミッ クス粒子の混合物により形成されるため、樹脂およびセ ラミックス粒子の配分比率を調整することにより、単位 構成要素の誘電率を容易に調整することができる。それ により、単位構成要素の屈折率を任意に調整することが できる。また、複数の単位構成要素を任意に組み合わせ ることができる。

ニックバンドギャップ効果を得ることが可能になり、任 意の波長を有する電磁波を完全に遮蔽することができ る。その結果、電磁波の波長選択性および指向性が得ら れ、かつ電磁波放射の高性能化およびエネルギー利用効 率の向上が可能となる。また、電磁波漏洩および電磁波 障害の防止が図られる。

【0011】このようにして、三次元周期構造体を応用 したデバイスの実用化が可能となる。しかしながら、よ り高い誘電率を有する三次元周期構造体を容易かつ安価 に実現することが望まれる。

【0012】本発明の目的は、高い誘電率を有し、容易 かつ安価に製造可能な三次元周期構造体を提供すること である。

【0013】本発明の他の目的は、高い誘電率の三次元 周期構造体を容易かつ安価に製造することが可能な製造 方法を提供することである。

[0014]

【課題を解決するための手段および発明の効果】本発明 者は、高い誘電率を有する三次元周期構造体をより容易 ための樹脂および粒子の材料および形態を種々検討しか つ実験した結果、複数種類の誘電体材料を複合化するこ とにより樹脂組成物の硬化反応を良好に維持しつつ単位 構成要素を容易に形成することができるという研究知見 を得た。そして、その研究知見に基づいて以下の発明を 案出した。

【0015】本発明に係る三次元周期構造体は、樹脂組 成物および誘電体粒子の混合物を硬化させることにより 形成される複数の単位構成要素が三次元周期的に組み合 わされ、誘電体粒子が複数種類の誘電体材料の複合体か 40 らなることを特徴とする。

【0016】なお、本発明における樹脂組成物および誘 電体粒子の混合物の硬化方法に制限はないが、通常、光 または熱によって硬化を行う。ここで、光とは、赤外 線、可視光線、紫外線、Χ線、電子線、α線、β線、γ 線等である。硬化方法としては、特に紫外線による硬化 が好ましい。

【0017】電磁波の波長 \(\(\) k C \(/\) f で表される。 ここで、kは定数、Cは電磁波の伝播する速さ、fは電 磁波の周波数である。波長 λ の電磁波に対してフォトニ 50

ックバンドギャップ効果を発現する三次元周期構造体の 周期dは1/2nに比例する。nは三次元周期構造体の 単位構成要素の材質の光学的屈折率である。この屈折率 nは材質の比誘電率 ε の平方根に比例するので、周期 d は $\lambda/2\sqrt{\epsilon}$ に比例する。このような関係から、三次元 周期構造体が有する固有の誘電率を選択するとともに周 期を調整することにより、特定の波長に対応したフォト ニックバンドギャップ効果を得ることが可能となる。

【0018】本発明に係る三次元周期構造体において 【0010】したがって、任意の波長に対応したフォト 10 は、単位構成要素が樹脂組成物と複数種類の誘電体材料 の複合体との混合物を硬化させることにより形成される ので、複合体を構成する誘電体材料として高い誘電率を 有する誘電体材料および樹脂組成物の硬化反応を妨げな い誘電体材料を選択することができる。それにより、樹 脂組成物の硬化反応を損なうことなく高い誘電率を有す る単位構成要素を形成することができる。

> 【0019】このように、三次元周期構造体の誘電率を 高めることにより、三次元周期構造体の周期を短くする ことが可能となる。それにより、三次元周期構造体によ り実現されるフォトニック結晶デバイスの小型化および 軽量化が可能となる。

> 【0020】また、複合体を構成する誘電体材料の配分 比率または樹脂組成物および複合体の配分比率を調整す ることにより、単位構成要素の誘電率を容易に調整する ことができる。それにより、単位構成要素の屈折率を任 意に調整することができる。また、複数の単位構成要素 の周期を任意に設定し、複数の単位構成要素を組み合わ せることができる。

【0021】したがって、任意の波長に対応したフォト かつ安価に製造可能にすべく、単位構成要素を形成する 30 ニックバンドギャップ効果を得ることが可能になり、任 意の波長を有する電磁波を完全に遮蔽することができ る。その結果、電磁波の波長選択性および指向性が得ら れ、かつ電磁波放射の高性能化およびエネルギー利用効 率の向上が可能となる。また、電磁波漏洩および電磁波 障害の防止が図られる。

> 【0022】また、単位構成要素の材料として複数種類 の誘電体材料の複合体と樹脂組成物との混合物を用いて いるので、加工または成形が容易であり、製造コストが 安くなる。

【0023】このように、高い誘電率を有し、容易かつ 安価に製造可能な三次元周期構造体が実現される。

【0024】複数種類の誘電体材料は第1の誘電体材料 および第2の誘電体材料を含み、第1の誘電体材料は第 2の誘電体材料よりも高い誘電率を有し、第2の誘電体 材料は第1の誘電体材料に比べて樹脂組成物の硬化を妨 げないことが好ましい。

【0025】この場合、樹脂組成物の硬化反応を良好に 維持しつつ、高い誘電率の単位構成要素を形成すること ができる。

【0026】誘電体粒子は、第1の誘電体材料からなる

粒子の表面が第2の誘電体材料からなる複数の粒子で取

り囲まれてなる二次粒子であってもよい。この場合、第 1の誘電体材料として高い誘電率を有する材料を選択 し、第2の誘電体材料として樹脂組成物の硬化反応を妨 げない材料を選択することにより、樹脂組成物の硬化反 応を損なうことなく高い誘電体率の単位構成要素を形成 することができる。

【0027】誘電体粒子は、第1の誘電体材料からなる 粒子と第2の誘電体材料からなる粒子とが混合されて一 体化されてなる二次粒子であってもよい。この場合、第 10 形成することができる。 1の誘電体材料として高い誘電率を有する材料を選択 し、第2の誘電体材料として樹脂組成物の硬化反応を妨 げない材料を選択することにより、樹脂組成物の硬化反 応を損なうことなく高い誘電率の単位構成要素を形成す ることができる。

【0028】誘電体粒子は、第2の誘電体材料の溶融凝 固体中に第1の誘電体材料からなる粒子が混入されてな る二次粒子であってもよい。この場合、第1の誘電体材 料として高い誘電率を有する材料を選択し、第2の誘電 体材料として樹脂組成物の硬化反応を妨げない材料を選 20 択することにより、樹脂組成物の硬化反応を損なうこと なく高い誘電率の単位構成要素を形成することができ ろ.

【0029】第1の誘電体材料は第1のセラミックスで あり、第2の誘電体材料は第2のセラミックスであって もよい。この場合、第1のセラミックスとして高い誘電 率を有するセラミックスを選択し、第2のセラミックス として樹脂組成物の硬化反応を妨げないセラミックスを 選択することにより、樹脂組成物の硬化反応を損なうこ となく高い誘電率の単位構成要素を容易かつ安価に形成 30 することができる。

【0030】第1の誘電体材料はセラミックスであり、 第2の誘電体材料はガラスまたはポリマであってもよ い。この場合、ガラスまたはポリマは樹脂組成物の硬化 反応を妨げないので、セラミックスとして高い誘電率を 有する材料を選択することにより、樹脂組成物の硬化反 応を損なうことなく高い誘電率の単位構成要素を容易か つ安価に形成することができる。

【0031】第2の誘電体材料は酸化シリコンであって もよい。酸化シリコンは樹脂組成物の硬化反応を妨げな 40 いので、第1の誘電体材料として高い誘電率を有する材 料を選択することにより、樹脂組成物の硬化反応を損な うことなく高い誘電率の単位構成要素を容易かつ安価に 形成することができる。

【0032】第1の誘電体材料は、酸化チタン、チタン 酸ストロンチウム、チタン酸バリウム、酸化タンタル、 酸化鉛および酸化バリウムよりなる群から選択された1 または複数のセラミックスであってもよい。酸化チタ ン、チタン酸ストロンチウム、チタン酸バリウム、酸化 タンタル、酸化鉛および酸化バリウムのうち2以上の化 50 においては、単位構成要素が樹脂組成物と複数種類の誘

合物の混合物または固溶体を用いてもよい。酸化チタ ン、チタン酸ストロンチウム、チタン酸バリウム、酸化 タンタル、酸化鉛および酸化バリウムは高い誘電率を有 するので、第2の誘電体材料として樹脂組成物の硬化反 応を妨げない材料を選択することにより、樹脂組成物の 硬化反応を損なうことなく高い誘電率の単位構成要素を 容易かつ安価に形成することができる。

【0033】樹脂組成物は光硬化性樹脂組成物であって もよい。この場合、光造形法により三次元周期構造体を

【0034】特に、三次元周期構造体が、少なくとも一 方向において他の部分と周期性が異なる部分を含んでも よい。この場合、特定の波長を有する電磁波を遮蔽する とともに、他の波長を有する電磁波を透過させることが できる。それにより、導波路または共振器を構成するこ とが可能となる。

【0035】複数の単位構成要素が二次元的に配列され て二次元基本構造体が形成され、複数の二次元基本構造 体が積層されてもよい。これにより、三次元周期構造体 が構成される。この場合、二次元基本構造体を構成する 複数の単位構成要素の配列周期および複数の二次元基本 構造体の積層周期を調整することにより、フォトニック バンドギャップ効果を発現する電磁波の波長を容易に制 御することができる。

【0036】単位構成要素は棒状体であり、複数の棒状 体が第1の方向に平行に所定間隔で配列されてなる二次 元基本構造体と、複数の棒状体が第1の方向に交差する 第2の方向に平行に所定間隔で配列されてなる二次元基 本構造体とが交互に積層されてもよい。この場合、棒状 体からなる単位構成要素を三次元周期的に容易に組み合 わせることができる。

【0037】三次元周期構造体が0.1mm以上30m m以下の周期を有してもよい。この場合、通信に使用さ れる電磁波に対してフォトニックバンドギャップ効果を 得ることができる。したがって、三次元周期構造体を通 信に使用される電磁波を制御するデバイスに応用するこ とができる。

【0038】特に、三次元周期構造の周期が1mm以上 3mm以下に設定された場合、ミリ波領域からマイクロ 波領域の電磁波を制御するデバイスへの応用が可能とな る。

【0039】本発明に係る三次元周期構造体の製造方法 は、複数種類の誘電体材料の複合体からなる誘電体粒子 を形成し、光造形法により、樹脂組成物および誘電体粒 子の混合物を硬化させることにより複数の単位構成要素 を周期的に配列してなる二次元基本構造体を形成し、複 数の二次元基本構造体を積み重ねることにより三次元周 期構造体を製造するものである。

【0040】本発明に係る三次元周期構造体の製造方法

8

電体材料の複合体との混合物を硬化させることにより形 成されるので、複合体を構成する誘電体材料として誘電 率の高い誘電体材料および樹脂組成物の硬化反応を妨げ ない誘電体材料を選択することができる。それにより、 樹脂組成物の硬化反応を損なうことなく高い誘電率の単 位構成要素を形成することができる。

【0041】このように、三次元周期構造体の誘電率を 高めることにより、三次元周期構造体の周期を短くする ことが可能となる。それにより、三次元周期構造体によ り実現されるフォトニック結晶デバイスの小型化および 10 軽量化が可能となる。

【0042】また、単位構成要素が複数種類の誘電体材 料の複合体と樹脂組成物との混合物を硬化させることに より形成されるので、複合体を構成する誘電体材料の配 分比率または樹脂組成物および複合体の配分比率を調整 することにより、単位構成要素の誘電率を容易に調整す ることができる。それにより、単位構成要素の屈折率を 任意に調整することができる。

【0043】また、複数の単位構成要素を周期的に配列 してなる二次元基本構造体を形成し、複数の二次元基本 20 構造体を積み重ねることにより三次元周期構造体を製造 するので、二次元基本構造体を構成する複数の単位構成 要素の配列周期および複数の二次元基本構造体の積層周 期を調整することにより、三次元周期を任意に設定する ことができる。

【0044】したがって、任意の波長に対応したフォト ニックバンドギャップ効果を得ることができる。

【0045】さらに、単位構成要素の材料として複数種 類の誘電体材料の複合体と樹脂組成物との混合物を用い ているので、加工または成形が容易であり、製造コスト 30 が安くなる。

【0046】これらの結果、高い誘電率の三次元周期構 造体を容易かつ安価に製造することができる。

[0047]

【発明の実施の形態】図1は本発明の一実施例における 三次元周期構造体の形成に用いるセラミックス二次粒子 の第1の例を示す模式図である。

【0048】図1において、第1のセラミックスからな る粒子201の外周面を第2のセラミックスからなる複 数の粒子202で被覆することにより、セラミックスニ 40 次粒子200が構成される。第1のセラミックスはTi O₂ (酸化チタン)、SrTiO₃ (チタン酸ストロン チウム)、BaTiO3 (チタン酸バリウム)、Ta2 Οε (酸化タンタル) 等からなり、第2のセラミックス はSiO2 (酸化シリコン)等からなる。また、第1の セラミックスとして、TiO2、SrTiO3、BaT iO₃、Ta₂O₅、PbO (酸化鉛) およびBaO

(酸化バリウム) のうち2以上の化合物の固溶体または 混合物を用いてもよい。このセラミックス二次粒子20

【0049】図2は本発明の一実施例における三次元周 期構造体の形成に用いるセラミックス二次粒子の第2の

例を示す模式図である。

ができる。

【0050】図2において、第1のセラミックスからな る粒子211と第2のセラミックスからなる粒子212 とを混合して焼結することにより、セラミックス二次粒 子210が構成される。第1のセラミックスはTi O2 、SrTiO3、BaTiO3、またはTa2 O5 等からなり、第2のセラミックスはSiO2等からな る。また、第1のセラミックスとして、TiO2、Sr TiO3、BaTiO3、Ta2 O5、PbOおよびB a Oのうち2以上の化合物の固溶体または混合物を用い てもよい。このセラミックス二次粒子210は、アトマ イズ法等により形成することができる。

【0051】図3は本発明の一実施例における三次元周 期構造体の形成に用いるセラミックス二次粒子の第3の 例を示す模式図である。

【0052】図3において、第2のセラミックスの溶融 凝固体222中に第1のセラミックスからなる粒子22 1を混入させることにより、セラミックス二次粒子22 Oが構成される。第1のセラミックスはTiO2、Sr TiO3、BaTiO3、またはTa2 O5 等からな り、第2のセラミックスはSiO2等からなる。第1の セラミックスとして、TiO2、SrTiO3、BaT iO3、Ta2O5、PbOおよびBaOのうち2以上 の化合物の固溶体または混合物を用いてもよい。このセ ラミックス二次粒子220は、溶融凝固法により形成す ることができる。

【0053】ここで、SiO2等の第2のセラミックス は比較的低い誘電率を有するが、樹脂の硬化反応を妨げ ない。一方、TiO2、SrTiO3、BaTiO3、 Ta2 Os、PbO、またはBaO等の第1のセラミッ クスは高い誘電率を有する。したがって、第1のセラミ ックスと第2のセラミックスと複合化してセラミックス 二次粒子を構成した場合、樹脂の硬化反応を損なうこと なく高い誘電率を有する混合物を得ることができる。

【0054】図1の例において、第1のセラミックスか らなる粒子201として誘電率が約125で比重が約4 のTiO2粒子を用い、第2のセラミックスからなる粒 子202として誘電率が約3.9で比重が約2.3のS i O₂ 粒子を用いることにより、直径 5 μ m程度のセラ ミックス二次粒子200を形成した。

【0055】図4はこのようにして形成されたセラミッ クス二次粒子200の顕微鏡写真を示す。このセラミッ クス二次粒子200の代表的な誘電率は約52となり、 比重は約3となる。このときのTiO2粒子の体積分率 は約40体積%であり、SiO2粒子の体積分率は約6 O体積%である。このようにTiO2粒子およびSiO 0は、気相反応法、アトマイズ法等により形成すること 50 2 粒子を複合化してセラミックス二次粒子を形成した場

10

合、SiO2粒子を単独で用いる場合に比べて高い誘電 率を得ることができる。

【0056】このようにして形成されたセラミックスニ 次粒子を樹脂組成物中に均一に分散させた混合物により 以下に示す方法で三次元周期構造体を製造することがで きる。

【0057】図5は本発明の一実施例における三次元周 期構造体の平面図、図6は図5の三次元周期構造体の正 面図、図7は図5の三次元周期構造体の側面図である。 図5~図7の三次元周期構造体は、立方格子構造を有す 10 る。

【0058】四角形の断面形状を有する複数の棒状体1 1が周期 d で平行にかつ等間隔で配置される。それによ り、第1層目の二次元基本構造体21が形成される。第 1層目の二次元基本構造体21上に、複数の棒状体11 が周期dで平行にかつ等間隔で配置される。それによ り、第2層目の二次元基本構造体22が形成される。第 2層目の二次元基本構造体22の棒状体11は、第1層 目の二次元基本構造体21の棒状体11と直角に交わる ように配置される。

【0059】第2層目の二次元基本構造体22上に、複 数の棒状体11が周期dで平行にかつ等間隔で配置され る。それにより、第3層目の二次元基本構造体23が形 成される。第3層目の二次元基本構造体23の棒状体1 1は、第2層目の二次元基本構造体22の棒状体11と 直角に交わり、かつ第1層目の二次元基本構造体21の 棒状体11に対して2分の1周期(d/2)ずれた位置 に配置される。

【0060】第3層目の二次元基本構造体23上に、複 数の棒状体11が周期dで平行にかつ等間隔で配置され 30 る。それにより、第4層目の二次元基本構造体24が形 成される。第4層目の二次元基本構造体24の棒状体1 1は、第3層目の二次元基本構造体23の棒状体11と 直角に交わり、かつ第2層目の二次元基本構造体22の 棒状体11に対して2分の1周期(d/2)ずれた位置 に配置される。

【0061】第1層目の二次元基本構造体21を構成す る棒状体11の本数は、第3層目の二次元基本構造体2 3を構成する棒状体11の本数よりも1本少なく、第4 数は、第2層目の二次元基本構造体22を構成する棒状 体11の本数よりも1本少ない。

【0062】以下同様にして、第1層目の二次元基本構 造体21、第2層目の二次元基本構造体22、第3層目 の二次元基本構造体23および第4層目の二次元基本構 造体24が所定の回数繰り返し順次積層される。

【0063】各棒状体11は、樹脂組成物中に図1、図 2または図3に示したセラミックス二次粒子を均一に分 散させた混合物を硬化させることにより形成される。樹 脂としては、例えばエポキシ系樹脂、アクリレート系樹 50 することができる。

脂等の種々の合成樹脂を用いることができる。

【0064】図8は図5~図7の三次元周期構造体を構 成する二次元基本構造体の1つの棒状体の端部の一部切 欠き平面図である。

【0065】図8に示すように、棒状体11を構成する 樹脂300中にセラミックス二次粒子200が均一に分 散していることが分かる。

【0066】ここで、棒状体11の誘電率を £1とす る。隣り合う棒状体11間には空間20が存在する。空 間20の誘電率を ϵ 2とする。これにより、誘電率 ϵ 1 の棒状体11と誘電率 ε2の空間20とが三次元的かつ 連続的に配置された格子状の周期的な繰り返し構造が得 られる。

【0067】TiO2からなる粒子201の表面をSi O2 からなる粒子202で被覆することにより図1のセ ラミックス二次粒子200を形成し、セラミックス二次 粒子200をエポキシ樹脂組成物中に均一に分散させた 混合物を用いて二次元基本構造体21,22,23,2 4を作製した場合、それらの二次元基本構造体21,2 2, 23, 24の誘電率は約11程度となる。このよう に、高誘電率のフォトニック結晶を構成する三次元周期 構造体を作製することができる。

【0068】このように、三次元周期構造体の誘電率を 高めることにより、三次元周期構造体の周期を短くする ことが可能となる。それにより、三次元周期構造体によ り実現されるフォトニック結晶デバイスの小型化および 軽量化が可能となる。

【0069】各棒状体11の寸法は任意に設定すること ができ、本実施例では、例えば1mm×1mm×50m mとする。また、周期dは任意に設定することができ、 本実施例では、周期 d を 0. 1 mm~30 mmに設定す る。一例として、周期dを2mmとする。

【0070】なお、本実施例では、四角形の断面形状を 有する棒状体11を用いているが、棒状体11の断面形 状は円形等の他の形状であってもよい。また、本実施例 では、三次元周期構造として立方格子構造を用いている が、立方格子構造に限らず三次元周期性を有する他の結 晶構造を用いてもよい。

【0071】本実施例の三次元周期構造体1において 層目の二次元基本構造体24を構成する棒状体11の本 40 は、セラミックス二次粒子を構成する第1のセラミック スからなる粒子および第2のセラミックスからなる粒子 の配分比率または樹脂組成物およびセラミックス二次粒 子の配分比率を調整することにより、棒状体11の誘電 率を容易に調整することができる。それにより、棒状体 11の屈折率を任意に調整することができる。また、棒 状体11の間隔を任意に設定することにより、周期 dを 任意に設定することができる。したがって、任意の波長 に対応したフォトニックバンドギャップ効果を得ること が可能になり、特定の波長を有する電磁波を完全に遮蔽

【0072】特に、周期de1mmから3mmに設定した場合、周波数 $2GHz\sim80GHz$ の帯域の電磁波を制御することが可能となる。

【0073】また、棒状体11が樹脂組成物およびセラミックス二次粒子の混合物を硬化させることにより形成されるので、加工および成形が容易であり、製造コストが安くなる。

【0074】図9は図5~図7の三次元周期構造体の製造方法の一例を示す模式的断面図、図10は図5~図7の三次元周期構造体の製造方法の一例を示す模式的斜視 10図である。以下、図9および図10を参照しながら図5~図7の三次元周期構造体の製造方法の一例について説明する。ここでは、液状の光硬化性樹脂組成物の感光反応を利用した光造形法を用いる。

【0075】図9および図10において、矢印Xおよび 矢印Yは平面内で互いに直交する2方向を示し、矢印Z は鉛直方向を示す。

【0076】光硬化性樹脂としてはエポキシ系光硬化性 樹脂、アクリレート系光硬化性樹脂等を用いる。この光 硬化性樹脂中に図1、図2または図3に示したセラミッ 20 クス二次粒子を混合し分散させる。

【0077】まず、図9(a)および図10(a)に示すように、テーブル50上に所定の厚み分の液状の光硬化性樹脂組成物が膜状に供給されるように、テーブル50を光硬化性樹脂組成物10に浸漬させる。この状態で、紫外線レーザ光30を矢印Xの方向に走査させる。それにより、紫外線レーザ光30の被照射部分の光硬化性樹脂組成物が硬化し、棒状体11が形成される。紫外線レーザ光30を矢印Xの方向と平行に繰り返し走査させることにより、矢印Xの方向に平行な複数の棒状体1301を所定間隔で形成する。これにより、テーブル50上に第1層目の二次元基本構造体が形成される。

【0078】次に、図9(b) および図10(b) に示すように、テーブル50を所定の厚み分矢印2の方向に下降させる。それにより、テーブル50上に形成された第1層目の二次元基本構造体上に所定の厚み分の液状の光硬化性樹脂組成物が供給される。この状態で、紫外線レーザ光30を矢印Yの方向に走査させる。それにより、紫外線レーザ光30の被照射部分の光硬化性樹脂組成物が硬化し、棒状体11が形成される。紫外線レーザ 40光30を矢印Yの方向と平行に繰り返し走査させることにより、矢印Yと平行な複数の棒状体11が形成される。それにより、第1層目の二次元基本周期構造体上に第2層目の二次元基本構造体が形成される。

【0079】同様にして、テーブル50を矢印Zの方向に下降させ、紫外線レーザ光30を矢印Xの方向に平行に繰り返し走査させることにより、第3層目の二次元基本構造体を形成し、さらにテーブル50を矢印Zの方向に下降させ、紫外線レーザ光30を矢印Yの方向に平行に繰り返し走査させることにより、第4層目の二次元基50

本構造体を形成する。

【0080】以下同様にして、第1層目、第2層目、第 3層目および第4層目の二次元基本構造体を所定の回数 繰り返し順次積層する。

12

【0081】このような光造形法を用いると、0.1mm $\sim 30mm$ の周期dを有する三次元周期構造体1を容易に作製することができる。

【0082】なお、樹脂組成物中に高い誘電率を有する セラミックス粒子を単独で分散させて混合した場合、セ ラミックス粒子の比重、大きさ、樹脂組成物中のセラミ ックス粒子の分量、樹脂組成物の光硬化反応におけるセ ラミックス粒子の光透過特性および反射特性等の種々の 条件に起因して、樹脂組成物の光硬化反応を良好に維持 することが困難になる場合が生じる。

【0083】これに対して、図1~図3に示したセラミックス二次粒子200,210,220を樹脂組成物中に分散させて混合した場合には、第2のセラミックスからなる粒子202,212または第2のセラミックスの溶融凝固体222の働きにより樹脂組成物の硬化反応を損なうことなく三次元周期構造体を形成することが可能となる。

【0084】図1~図3の例では、二次粒子を構成する 誘電体材料としてセラミックスを用いているが、セラミックスに限らず他の誘電体材料を用いてもよい。この場合、第2の誘電体材料としては、光透過特性が良好であり、光硬化性樹脂組成物の光硬化反応性を妨げず、光硬化性樹脂組成物の混合物として流動性に優れた材料を選択することが好ましい。例えば、第2の誘電体材料としてガラスを用いることができ、あるいはラテックス、アクリル等のポリマを用いることができる。この場合、図1の第2のセラミックスからなる粒子202、図2のセラミックスからなる粒子202、図2のセラミックスからなる粒子212および図3の溶融疑固体222の代わりにガラス、ポリマ等を用いる。

【0085】図11は本発明の他の実施例における三次元周期構造体の正面図である。図11の三次元周期構造体1においては、一部分に格子欠陥60が設けられている。この格子欠陥60の部分では、周期性が他の部分の周期性と異なる。そのため、格子欠陥60を除く部分で特定の波長を有する電磁波に対するフォトニックバンドギャップ効果が得られ、格子欠陥60の部分では、特定の波長を有する電磁波に対するフォトニックバンドギャップ効果が得られない。

【0086】したがって、格子欠陥60を連続的に形成することにより、特定の波長を有する電磁波を伝搬する 導波路が形成される。

【0087】また、三次元周期構造体1に異なる周期性を有する領域を形成し、異なる周期性を有する領域の界面を対向させることにより、特定の波長を有する電磁波に対する共振器を形成することができる。

【0088】このように、三次元周期構造体1の一部に

13 周期性の異なる部分を設けることにより、電磁波の指向 性を制御することができる。

【0089】図12は図5~図7の三次元周期構造体を アンテナに応用した例を示す模式的斜視図である。

【0090】図12において、図5~図7の構造を有す る平面状の三次元周期構造体1によりアンテナが形成さ れている。この三次元周期構造体1の一方の面に1対の 電極80が設けられている。三次元周期構造体1が特定 の波長を有する電磁波に対する遮蔽効果を有するため、 電極80から発生される特定の波長の電磁波100は矢 10 印Aの方向に放射され、矢印Bの方向には放射されな V.

【0091】このように、図5~図7の三次元周期構造 体1を用いることにより高指向性のアンテナが実現す る。三次元周期構造体1の周期dを1mm~3mmに設 定した場合、2GHz~80GHzの電磁波に対する波 長選択性および高指向性が得られる。

【0092】例えば、飛行船通信に応用する場合、利用 が予定されている約30GHzのミリ波帯の電磁波に対 して高い誘電率を示す図1、図2または図3のセラミッ 20 クス二次粒子200,210,220を均一に分散させ た樹脂組成物を用いることにより、アンテナに高指向性 を付与することができる。

【0093】したがって、図12のアンテナを用いるこ とにより、ミリ波領域およびマイクロ波領域の電磁波を 使用する通信機器の出力特性の高性能化が可能となる。 また、電磁波が特定の方向に集中するため、エネルギー 利用効率が向上し、携帯機器の使用時間を延長すること が可能となる。さらに、電磁波の放射角が限定されるの で、使用者や他の電子機器に対する電磁障害が防止され 30 る。

【0094】以上のように、上記実施例の三次元周期構 造体1において、棒状体11の誘電率の選択および周期 構造の制御により、特定の波長を有する電磁波を完全に 遮蔽することができる。それにより、種々のデバイスに 電磁波の波長選択性、指向性および導波機能を付与する ことができ、特定方向への送信効率の向上および電磁障 害の防止が可能となる。

【0095】したがって、三次元周期構造体1を用いて 新しい高機能通信機器用の部品の作製が可能となるとと 40 もに、通信機器の高出力化に伴って高効率化および電磁 障害防止を図ることができる。それにより、グローバル 移動体通信、超高速インターネット、ビデオオンデマン ド、高品位テレビ伝送などを利用したマルチメディア社 会に必要な高速大容量通信インフラストラクチャおよび 電磁波障害に強い通信システムを提供することが可能と なる。

【0096】また、高指向性マイクロ波移動体通信機用 のアンテナの量産技術を提供することにより、人工衛星 を利用したグローバル移動体通信システムおよび飛行船 50 1 三次元周期構造体

を中継基地とする高速大容量通信システムにおけるミリ 波帯通信機器の高性能化および小型化が可能となる。さ らに、自動運転を可能にする高度道路交通システム用の ミリ波帯アンテナの高性能化による交通安全世界の実現 など、通信環境の一層の発展を期待できる。

【0097】特に、ミリ波帯またはマイクロ波帯通信の 高機能化および電磁漏洩に対する安全性を確保する電磁 障害防止デバイスとしての製造技術を提供することが可 能となる。

【0098】さらに、サブミリ単位の三次元周期構造体 1により約80GHz帯のミリ波帯アンテナへの応用が 可能となるとともに三次元周期構造体1を利用したアン テナ以外の多種多様なデバイスの製作が可能となる。

【0099】また、光領域においては、高効率のレーザ 発振を可能とする光共振器、光導波路等の実現が可能と なる。

【0100】また、三次元周期構造体の誘電率を高める ことにより、三次元周期構造体の周期を短くすることが 可能となる。それにより、三次元周期構造体により実現 されるフォトニック結晶デバイスの小型化および軽量化 が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における三次元周期構造体の 形成に用いるセラミックス二次粒子第1の例を示す模式

【図2】本発明の一実施例における三次元周期構造体の 形成に用いるセラミックス二次粒子の第2の例を示す模 式図である。

【図3】本発明の一実施例における三次元周期構造体の 形成に用いるセラミックス二次粒子の第3の例を示す模 式図である。

【図4】第1の例のセラミックス二次粒子の顕微鏡写真 を示す図である。

【図5】本発明の一実施例における三次元周期構造体の 平面図である。

【図6】図4の三次元周期構造体の正面図である。

【図7】図1の三次元周期構造体の側面図である。

【図8】図5~図7の三次元周期構造体を構成する二次 元基本構造体の1つの棒状部材の端部の一部切欠き平面 図である。

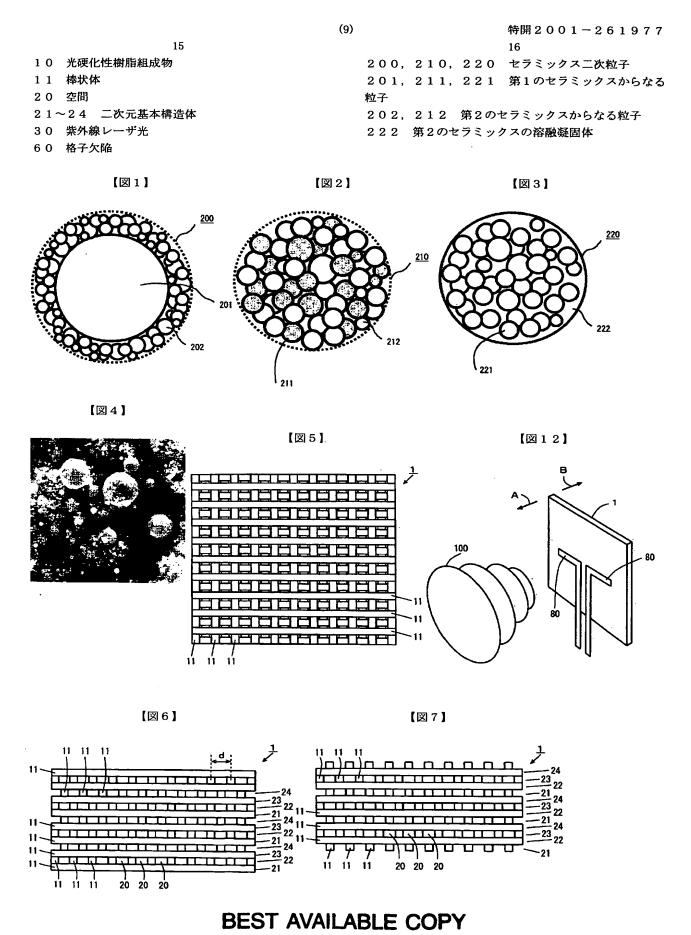
【図9】図5~図7の三次元周期構造体の製造方法の一 例を示す模式的断面図である。

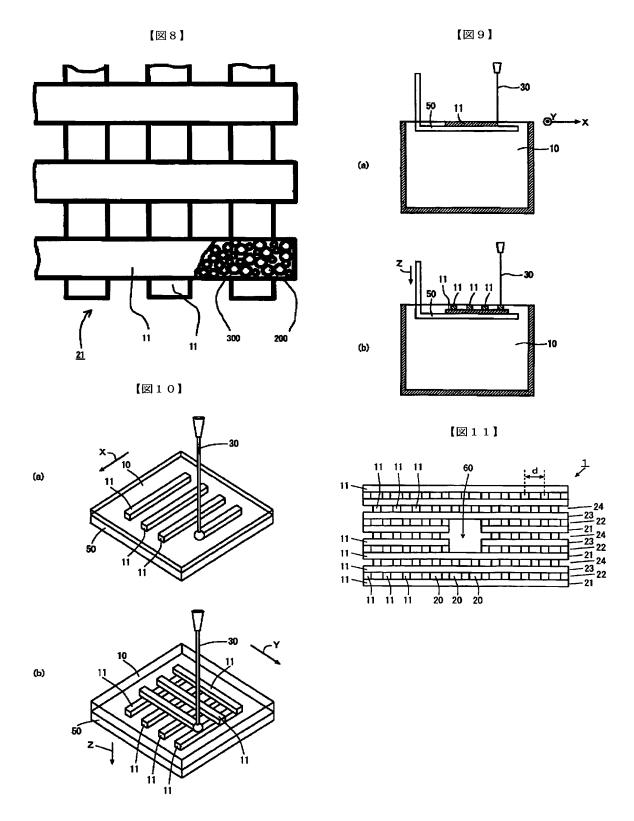
【図10】図5~図7の三次元周期構造体の製造方法の 一例を示す模式的斜視図である。

【図11】本発明の他の実施例における三次元周期構造 体の正面図である。

【図12】図5~図7の三次元周期構造体をアンテナに 応用した例を示す模式的斜視図である。

【符号の説明】





フロントページの続き

(51) Int. Cl.	7 識別記号		FΙ		テーマコード(参考)
G 0 2 B	6/12		H 0 5 K	9/00	W 5J046
H 0 5 K	9/00		H 0 1 Q	1/38	
// H01Q	1/38			9/16	
	9/16		H 0 1 S	5/20	
H 0 1 S	5/20		G 0 2 B	6/12	Z
					N
(72)発明者	桐原 聡秀		Fターム(参	*考) 2HO47	QA00 QA04 QA05
	大阪府箕面市粟生新家2-1-27	ヴェル		4F071	AA31 AA42 AB18 AB19 AH12
	ドミール205号室				BC07
(72)発明者	田上 英二郎			4J002	AA001 BG001 CD001 DE096
	東京都中央区築地2丁目11番24号	ジェイ			DE136 DE186 FD126 GP00
	エスアール株式会社内				GQ00
				5E321	BB51 BB60 GG05
				5F073	BAO1 EA14
				5,J046	AA01 AB07 BA03 KA07 UA03
					UA08

THIS PAINT MANUK IUSON

THIS PAGE BLANK (USPT))